

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 03-019888

(43) Date of publication of application : 29.01.1991

(51) Int.Cl.

B41M 1/08  
B41M 1/10  
B41M 3/00  
B41M 7/00

(21) Application number : 01-153841

(71) Applicant : DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22) Date of filing : 16.06.1989

(72) Inventor : OKAZAKI AKIRA

MATSUI HIROYUKI

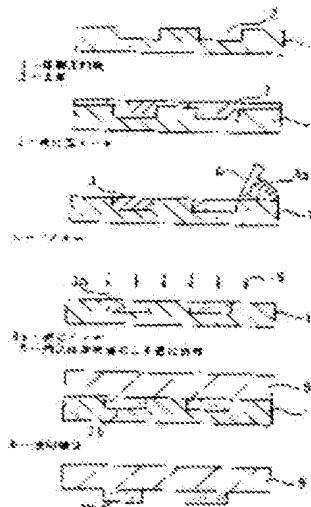
TAKEUCHI SATOSHI

## (54) PRINTING METHOD OF VERY FINE PATTERNS

## (57) Abstract:

**PURPOSE:** To print with very fine patterns in compliance with the plate by patterning a setting ink to very fine patterns by use of an intaglio or a lithography, sufficiently hardening said setting ink not to be fluidic, and transferring said ink to a target body while the shape of said ink is maintained.

**CONSTITUTION:** A recessed portion 2 which will be a printing area is formed in an intaglio 1, and a setting-type ink 3 is applied onto the surface of the intaglio 1. The setting ink 3 is preferably of a type set by heat or ionizing radiation, etc., without containing a solvent and with the relatively low viscosity. After the ink 3 is applied, an unnecessary ink 3a on the surface of the intaglio 1 is scraped and removed by a doctor 4. Then, the ink 3 in the recessed portion 2 is processed by heat or ionizing radiation 5 so that the ink is set. The fluidity of the ink disappears because of the increase of the viscosity or the setting reaction. As a result, the ink is turned to be a hardened ink 3b. After the ink is hardened, a target body 6 to be transferred is overlapped with the intaglio 1 and tightly bonded with each other. Then, when the body 6 and intaglio 1 are separated from each other, the hardened ink 3b in the recessed portion 2 of the intaglio 1 is transferred onto the body 6.



---

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## ⑪ 公開特許公報 (A) 平3-19888

⑫ Int. Cl. \*

B 41 M 1/08  
1/10  
3/00  
7/00

識別記号

序内整理番号

7029-2H  
7029-2H  
7029-2H  
7029-2H

⑬ 公開 平成3年(1991)1月29日

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全7頁)

⑭ 発明の名称 微細パターンの印刷方法

⑮ 特 願 平1-153841

⑯ 出 願 平1(1989)6月16日

⑭ 発明者	岡崎	暁	東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 大日本印刷株式会社内
⑭ 発明者	松井	博之	東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 大日本印刷株式会社内
⑭ 発明者	武内	敏	東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 大日本印刷株式会社内
⑭ 出願人	大日本印刷株式会社		東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号
⑭ 代理人	弁理士 細井 勇		

## 明細書

⑰ 発明の名称

微細パターンの印刷方法

⑱ 特許請求の範囲

- (1) 印刷用顔料となる微細なパターン部を形成してなる印刷用顔料に硬化型インキを塗布してドクターにて凹部以外のインキを除去して凹部のみにインキを残させるか、若しくは印刷用顔料となる微細なパターン部を露版してなる印刷用平版に硬化型インキを塗布して該インキをパターン部のみに着色させてパターンニングし、次いで、凹版又は平版上のインキを熱又は放射線で硬化させた後に被印刷体に転写することを特徴とする微細パターンの印刷方法。
- (2) 被印刷体に予め接着性又は粘着性層を設けた後、該層を介して硬化後のインキを被印刷体に転写する請求項1記載の印刷方法。
- (3) 凹版又は平版上で硬化型インキをパターンニングさせた後、若しくはパターンニングされたインキを硬化させた後に断面に接着性又は粘

着性層を設け、かかる後、該層を介して硬化後のインキを被印刷体に転写する請求項1記載の印刷方法。

(4) 被印刷体が金属、セラミック、ガラス又はプラスチック板の属性を有するものである請求項1～3記載の印刷方法。

(5) 硬化後のインキを転写させた後、被印刷体上の硬化インキ層が存在しない部分にある接着性又は粘着性層を除去する請求項2～4記載の印刷方法。

## ⑲ 告明の詳細な説明

〔商業上の利用分野〕

本発明は微細パターン形成を印刷手段にて行う微細パターンの印刷方法に係わり、例えば電子部品に供給する微細回路や電子パターンなどの微細レジストパターンを高精度で且つ量産的に形成するに好適な印刷方法に関する。

〔従来の技術

及び発明が解決しようとする課題〕

従来より印刷記録やガラス、セラミック板上の

繊維パターンの形成度合いは金属版の食料用レジストパターンの形成などに際しては、スクリーン印刷法やオフセット印刷法のような印刷手段が広く採用されている。しかし、これらの印刷手段は比較的繊維巾の大きさ（200μm以上）パターン形成には適していたが、繊維幅がそれ以下の微細なパターン形成には不向きであるということが要因であった。しかも、印刷されるパターンはインキの流動性、版の圧力などの影響でインキの一部が転移しないで版に残留する等により変形したものとなってしまい、印刷パターンの再現性に劣るという欠点もあった。

例えば、スクリーン印刷法はメッシュ網スクリーンにインキ遮蔽マスクを形成し、該マスクの非マスク部を所望のパターンとし、非マスク部からインキを通過させて被印刷体に付着させて印刷を行うものであるが、この印刷法ではインキの厚膜り（数mm～20μm厚）が容易なために耐熱性の優れたレジストパターンの印刷が可能なもの、实用印刷線巾が最小のものでも200μm程度が

限界であるために複雑微細なパターンの印刷を行うのは困難であった。

またオフセット印刷法はP/L版（Presensitized Plate）に親油性部と親水性部を形成し、親水性部に水分を保持させて油性インキを反発させ、親油性部の方に選択的にインキを付着させ、かかるインキパターンを被印刷体に印刷する方法であり、特に印刷適性を上げるためにP/L版上のインキパターンを一度、ゴムブランケットに転写した後に紙等の被印刷体に再転写するよう構成されている。しかし、この印刷法は比較的微細な繊維が得られないが、インキング方式や2回の転写操作等の関係により印刷されるインキ膜厚が1～2mm程度の小さいものとなる傾向があり、そのため印刷繊維はピンホールや断線が発生し易い欠点がある。また、この印刷法ではインキの塗膜厚を大きくし耐熱性に優れた繊維パターンを形成し得る様に各種の工夫がなされているが、膜厚を大きくすると印刷繊維が太くなり、結局のところ100～200μm程度の線巾の印刷が限界であった。

従って、上述の印刷法では繊維印刷を使用しようとしても基本的に100～200μm程度の線巾の印刷が限界であって、より小さい線巾のパターンを印刷しようとするにはインキ膜厚も同時に小さくなってしまうため、特にレジストパターンの如き耐熱性を要する繊維パターン形成には適用不可能であった。

このように印刷方法では繊維パターンの形成が困難である上に、印刷されるパターンが必ずしも繊維パターンに忠実のものには成り得ず再現性の点でも不充分であったために、特に繊維パターン形成には一概にフォトリソグラフィーに依存せざるを得なかった。ところが、このフォトリソグラフィーは極めて微細なパターン形成が可能であるが、印刷手段に比べて工程が複雑で生産性が低く且つコスト嵩となる不具合があった。

一方、印刷版において比較的繊維で印刷膜厚も大きくして構成することができる印刷手段に凹版印刷法がある。この印刷法は鋼版などに露刻法や食刻法で繊維凹部を形成し、該凹部に吸着のイン

キを擦り込み、非繊維部のインキを拭き取った後に印刷版上に印刷用紙をあて発圧して印刷を行うものである。発圧する理由は凹部に擦りこまれたインキが版表面より深んだ位置にあるため、紙のような柔軟性被印刷物に捺正着させることにより強制的にインキ面と被印刷物面とを接触付着させてインキを被印刷物に転移させるためである。

しかしながら、従来の凹版印刷法は上記のスクリーン印刷法やオフセット印刷法に比し繊維印刷に適しているにも係わらず、剛性の高いプラスチック、ガラス、セラミック、金属性からなる基板等への印刷が殆ど不可能であるという大きな問題点がある。

本発明は上記の問題点に鑑みなされたもので、従来の印刷法よりも繊維が複雑で且つインキ膜厚も適度な厚みである繊維パターンを印刷形成することができ、しかも、かかる繊維パターンを各種の被印刷体に正確且つ鮮明に、また能率的且つ安価に形成し得る繊維パターンの印刷方法を提供することを目的とする。

## 〔課題を解決するための手段〕

即ち本発明は、

- (1) 印刷面線部となる繊維なバターン版部を形成してなる印刷用凹版に硬化型インキを塗布してドクターにて凹部以外のインキを除去して凹部のみにインキを充填させるか、若しくは印刷面線部となる繊維なバターン版部を製版してなる印刷用平版に硬化型インキを塗布して該インキをバターン版部のみに着色させてバターンエンジングし、次いで、凹版又は平版上のインキを熱又は放射線で硬化させた後に被印刷体に転写することを特徴とする繊維バターンの印刷方法。
- (2) 被印刷体に予め接着性又は粘着性層を設けた後、該層を介して硬化後のインキを被印刷体に転写する請求項1記載の印刷方法。
- (3) 凹版又は平版上で硬化型インキをバターンエンジングさせた後、若しくはバターンエンジングされたインキを硬化させた後に版表面に接着性又は粘着性層を設け。しがる後、該層を介して硬化後のインキを被印刷体に転写する請求項1記載の

次に、本発明を前面に基づき印刷工程順に述べて説明する。

第1図は本発明印刷方法の各工程例を示すものである。同図(A)は本発明に使用する製版された印刷用版1を示す。この版1としては図示の如き凹版かあるいは特に図示しないが平版が使用される。版1は図示の如き平板状のものに限定されず、例えばガムローラ等に巻き付けて円筒状に構成したものであっても良い。

版1が凹版の場合、凹版1には印刷面線となる凹部2が形成されており、また版1が平版の場合、平版には上記凹版2に相当するバターン版部が製版されている。この凹版2の形成方法は特に限定されるものではなく、例えば、平滑に研磨された金属製版材(一般に鋼、鋼合金、鉄、鉄合金等、その後の金属)を微細切削法にて切削形成したり、或いは該版材にフォトファブリケーションを利用して光学的にシジストマスクを設けた後、エッチングして形成することができる。凹部2はその縁幅が5~50μm程度、深さ(版深)が1~1.0

## 印刷方法。

- (4) 被印刷体が金属、セラミック、ガラス又はプラスチック等の堅性を有するものである請求項1~3記載の印刷方法。
- (5) 硬化後のインキを転写させた後、被印刷体上の硬化インキ層が存在しない部分にある接着性又は粘着性層を除去する請求項2~4記載の印刷方法。

を要旨とするものである。

## (作用)

本発明の印刷方法は、版として凹版又は平版を使用して硬化型インキを繊維で適度の膜厚からなる繊維バターンにバターンエンジングすることができる。そのようにバターンエンジングした硬化型インキを充分に硬化させてから、即ち非流動性にすると共に版上でバターンエンジングされた形状をそのままに保持させてから被印刷体に硬化インキを転写させるものであり、その結果、版通りの繊維バターンからなる硬化インキ層を変形させることなしに被印刷体に印刷形成することができる。

μm程度の繊維なものとして構成することができる。また版材はガラス、セラミック等の堅質の材質からなるものを使用してもよい。更に、凹版1表面の硬度を増すために製版面にエッケル、クロム等の硬質金属をメッキしてもよく、これによりドクターによるインキ運び落とし時の耐久性を付与することができる。平版のバターン版部の形成に当たっては平版印刷で採用されている公知の製版方法を適用できる。

次いで、上記の印刷用版(凹版)1面に硬化型インキ3を塗布する(第1図(B))。インキの塗布はインキ槽めに版を浸漬させて行ったり、版面にインキをかけ塗りして行う等により容易になし得る。

本発明に使用される硬化型インキ3は熱硬化タイプ、電離放射線硬化タイプ等のものであり、これらは無溶剤系のもので且つ比較的低粘度のものが好ましい。具体的には一般に市販されている紫外線硬化型インキ、電子線硬化型インキ、赤外線(又は熱)硬化型インキ等を利用することができます。

本発明は上記のような公知のインキを適用できることも非常に有利な点である。インキ3の基本組成は、紫外線硬化型インキを挙げて説明すると、溶剤を用いずに感光性のアレボリマー又はモノマーと光重合開始剤を結合剤とし、着色用顔料と適当な増感剤やタック調整剤等のインキ助剤類から構成されている。また通常の紫外線硬化型インキに代えて、半導体加工やフォトエッチング等に使用されているフォトレジスト材料から適宜選択したものを使用してもよい。更に平版用インキとしては従来の平版印刷法の如く粘度のインキを使用する必要はなく、若干低粘度のものを使用できる。このインキの粘度調整は結合剤である光重合開始剤を含むアレボリマー又はモノマーのうちで低粘度のものを選択使用すればよい。

版1にインキ3を塗布した後、版1が凹版の場合には第1図(C)に示すように凹版1面の不要なインキ3を薄い金属プレート等からなるドクター4でかき取って除去し、印刷導線となる凹部2のみにインキ3を残留充填させる。一方、版1

また平版の場合でも版上の硬化インキが溝様に被印刷体6に転写される。この場合における被印刷体6としては紙や薄いフィルムなどの柔軟性を有するものが好ましい。

本発明の印刷方法は、被印刷体6が金属、セラミック、ガラス、プラスチック等のような剛性を有するものである場合、第2図又は第3図に示すように被印刷体6側若しくは(四)版1側に接着性又は粘着性層7を溝状形成し、該層7を版と被印刷体6に転写させる(第4図)。かかる構成により被印刷体表面と硬化インキ表面とを直接接触させにくかったり。或いは良好に接触させてもインキが硬化したものあるため被印刷体に接着しにくい等の影響による硬化インキ3との被印刷体への転移の不安定さを解消することができ、以て、剛性を有する如鋼なる被印刷体へも安定的で確実な印刷が可能となる。

接着性又は粘着性層7を版1側に設ける場合、該層7は硬化型インキを凹部2やバターン部等に

が平版であれば塗布された硬化型インキ3は、版とインキとの表面エネルギーの相互作用により自然にバターン版部のみに着色する。いずれの版においても、この段階でインキ3のバターンニングがなされる。

次いで、第1図(D)に示すように凹部2のインキ3に対して熱又は放射線による硬化処理5を施して該インキを反応活性化させ、該凹部2内で増粘又は硬化反応を生じせしめ、インキの柔軟性を消滅させて硬化(固形)インキ3'とする。平版の場合にも版上において凹版と同様に増粘又は硬化反応が生じ、バターンニングされたインキ3が硬化インキ3'となる。この際のインキの硬化度合いはゲル分率にて表わすと全体が90%以上とするのが適当である。

インキを硬化させた後、版1に被印刷体6を重ね合わせて両者を接着させ(第1図(E))、熱いて両者を引き離すことにより版1の凹部2内の硬化インキ3'が被印刷体6上に転写され(同図(F))、本発明印刷方法による印刷がなされる。

バターンニングされた後、或いはバターンニングさせた硬化型インキを硬化させた後に版表面の全面に形成する。上記層7を形成する接着剤又は粘着剤は塗布適性に優れ且つ版1表面に対して接着又は粘着力が弱いものを市販品から選択して使用すればよい。例えば、所要する工程によってその接着・粘着過程が溶剤感活性型、熱感活性型、圧力感活性型、化学反応型等のうちから適宜選択して使用することができ、なかでも圧力感活性型である感圧接着剤(粘着剤)や熱感活性型であるホットメルト型接着剤等が好ましい。

本発明では接着性又は粘着性層7を介して印刷を行った場合、第4図に示すように被印刷体6面には転写された硬化インキ3'が存在しない非転写部にも層7'が存在するが、必要に応じて該層7'を適宜手段にて除去する(第5図)。この除去処理により非転写部に相当する被印刷体6表面を露出させることができる。この除去手段としてはインキ層3'がスッキングレジスト印刷である場合、アラバマ等のドライスッキング法や適当

なエッティング液によるウエットエッティング法等がある。他の除去手段としてはオゾン酸化、放射エネルギー分解、或いは溶剤や薬品による溶解除去法等が採用できる。

上記の如き構成からなる本発明の印刷方法は微細パターン形成を要す用途に広く利用することができる。例えば、本発明は被印刷体に接着性又は接着性層を介して微細パターンを印刷し、次いで非導線部の上記層を除去した後、更に必要に応じて露出した被印刷体の非導線部をドライ又はウエットエッティングにて食刻し、食刻後に硬化インキ層を(上記層も含々)除去するような用途にも採用して有効である。

#### (実施例)

以下、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明する。

#### 実施例1

研磨された厚さ0.15mmの鋼板にフォトレジストで解像力チャートをパターンニングし、酸素第三鉄溶液を用いてエッティングして深さ3mmの溝

これにより、硬化インキ層部分はエボキシ成分によるベンゼン環の存在により酸素プラズマに焼かれ難い。一方のアクリル系樹脂からなる接着剤層部分は酸素プラズマにより焼され難いため、結果的に接着剤層のみが露出している非導線部の接着剤層部分が除去された。

以上の工程により、ガラス板上に線巾3.0mm、膜厚4μm(インキ層3μm+接着剤層1μm)の溝線が鮮明に印刷され、凹版に食刻された解像力チャートが正確に再現されていた。

#### 実施例2

実施例1で使用した凹版に1mm厚のクロムマスクをしたドクタリングに対する耐久性を強化し、その凹版を用いて同様に凹版ローラを作成した。次いで、凹版面にノボラック-メラミン系熱硬化型インキを塗布した後、板上の凹部以外のインキをドクターで落として除去した。

しかし後、凹版面に向けて遠赤外線を照射してインキを硬化せしめた。

一方、ガラス板にクロムを蒸着した面に手め

細パターンからなる凹版を製版した。フォトレジストを除去した後、この凹版を硬いゴムローラに巻きつけて凹版ローラとし、この凹版面にアクリル-エボキシ系紫外線硬化型インキを塗布し、次いでグラビア印刷用ドクターブレードを用いて凹版の凹部以外の非導線部のインキを落として除去した。

次いで、凹版面に向けて紫外線を照射して凹版凹部に光重されているインキを硬化させた。インキ硬化後、凹版ローラ上にアクリル樹脂系接着剤を塗膜厚1μmとなるよう全面に塗布した。

次に、この凹版ローラを清浄したガラス板上に載置してゆっくりと転がし、接着剤層を介して凹版の硬化したインキをガラス板上に転写させた。この結果、凹版凹部内の硬化インキは残存することなく完全にガラス板側に転移され、線巾が3.0mm迄の微細な溝線がシャープに印刷されたことが確認された。

その後、このガラス板を酸素プラズマ露風気中に10分間暴露してプラズマエッティングを行った。

アクリル系接着剤を1μm厚で全面に塗布した被印刷体を用意し、その面上に上記凹版ローラを載置して転がしたところ、凹版面の硬化インキは完全にガラス板側に転移した。このガラス板を実施例1と同様に酸素プラズマで処理し、非導線部の接着剤層部分を除去した。酸素プラズマによる処理の際、硬化インキはノボラック成分に由来するベンゼン環により焼されなかった。

以上の工程により、ガラス板上のクロム蒸着層面に線巾3.0mm、膜厚4μm(インキ層3μm+接着剤層1μm)以上の微細溝線が鮮明に印刷された。凹版に食刻された微細パターンが正確に再現された。

#### 実施例3

版として版深2mmの水無し平版(東レ製)を用い、これをゴムローラに巻き付けて凹版ローラとし、この凹版ローラの版面にアルキッド樹脂を生成分とする硬化重合型水無し平版用インキを塗布した。版とインキの表面エネルギーの相互作用によりインキが所定のパターン形状になった後、

遠赤外線を版刷ローラ表面に照射してインキを硬化させしめた。インキ硬化後、版刷ローラ上にアクリル樹脂系粘着剤を1μm厚となるよう全面に塗布した。

次いで、この版刷ローラをガラス基板上に転がして粘着剤層を介して硬化インキをガラス基板に転写した。このガラス基板を酸素プラズマ露置気中に10分間露置し、これにより硬化インキ部分はアルキッド成分に由来するベンゼン環により接着アラズマに接着されずに残存し、アクリル系樹脂からなる粘着剤層部分は酸素アラズマにて容易に接着され、その結果、硬化インキに覆われていない粘着剤層部分のみが除去された。

以上の工程により、ガラス基板上に幅巾3.0mm、膜厚3μm(インキ層2μm+粘着剤層1μm)の露置からなる微細パターンが精度良く印刷再現された。

#### 実施例1

版として版幅2mmのP/S版を用い、これをガラスローラに巻き付けて版刷ローラとし、この版刷

ローラに温し水を水付けローラにて与えた後、ローラ表面性フェノール樹脂を生成分とする半導用インキを塗布した。版と水とインキの表面はオルギーの相互作用によりインキが所定パターン形状になった後、ローラ表面に遠赤外線を照射してインキを硬化させしめた。

次いで、この版刷ローラをガラス基板上に転がして粘着剤層を介して硬化インキをガラス基板に転写した。このガラス基板を酸素アラズマ露置気中に10分間露置し、これにより硬化インキ部分はフェノール成分に由来するベンゼン環により接着アラズマに接着されずに残存し、アクリル系樹脂からなる粘着剤層部分は酸素アラズマにて容易に接着され、その結果、硬化インキに覆われていない粘着剤層部分のみが除去された。

以上の工程により、ガラス基板上に幅巾3.0mm、膜厚3μm(インキ層2μm+粘着剤層1μm)の露置からなる微細パターンが精度良く印刷再現された。

#### (発明の効果)

露置の形成を能率的に且つ安価に行うことが可能となった。更に本発明方法は接着性又は粘着性層を介して印刷を行うことにより、剛性を有するような被印刷体にも硬化インキを安定的に且つ簡便に転写せしめることができる。

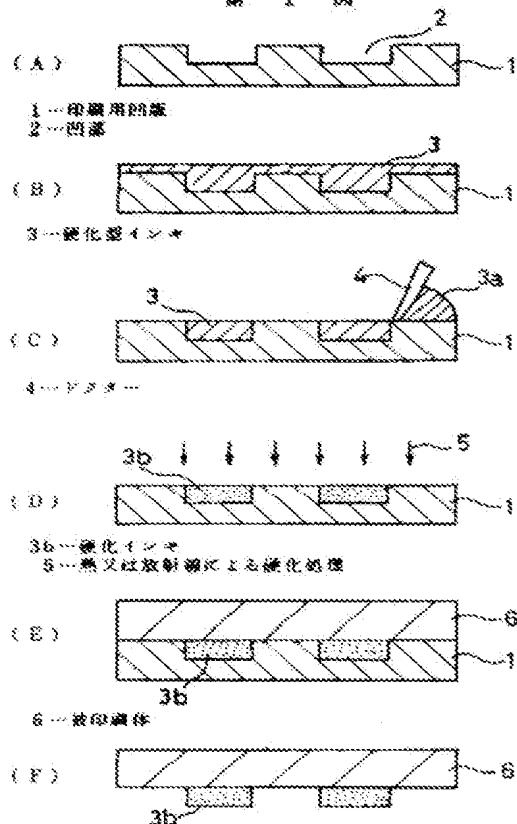
従って、本発明印刷方法は微細パターン形成の用途に広く適用でき、例えば、ガラスフィットマスクや微細なプリント回路板、その他の微細パターン形成を要する製品を高精度で安価に加工提供することができる、実益大である。

#### 4.印刷の簡単な説明

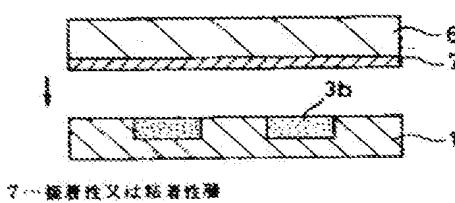
第1図(A)～(D)は本発明印刷方法の各印刷工程の一実施例を示す断面説明図、第2図～第6図は本発明の印刷方法における異なる様様の印刷工程例を示す断面説明図である。

- 1…印刷用版(凹版) 2…凹部
- 3…硬化型インキ 3.5…硬化インキ
- 4…ドクター
- 5…熱又は放射線による硬化処理
- 6…被印刷体 7…接着性又は粘着性層

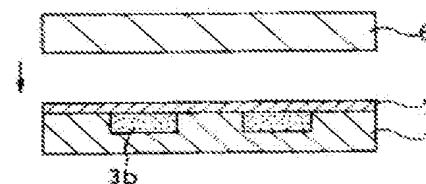
第 1 図



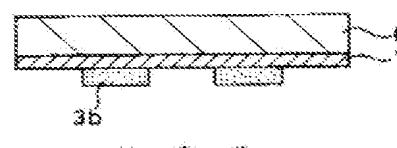
第 2 図



第 3 図



第 4 図



第 5 図

